

一般社団法人エレクトロニクス実装学会 関西支部

第26回若手研究会セミナー

“材料力学から見た” 電子実装部の信頼性評価

エレクトロニクス製品の小型化、薄膜化、高性能化が加速する中、そのデバイスの信頼性確保がますます重要になっています。電子実装部の信頼性は、電子機器の信頼性を大きく左右するため、重要な問題であり、電子工学的な見地、材料工学的な見地、化学的な見地、機械工学的な見地などから、多角的に評価が行われています。

本セミナーでは、鹿児島大学の池田 徹 先生に、“材料力学的な見地からの強度信頼性評価手法”について、樹脂と金属基板のはく離強度評価・パッケージの反りの予測・パッケージ内部の微細接合部のひずみ測定とそのシミュレーション技術などを例にとりてわかりやすく解説していただきます。若手・中堅技術者の方だけでなく、実装デバイスの信頼性に関連した実装技術の現状を俯瞰されたい方まで、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会関西支部
協 賛：溶接学会マイクロ接合研究委員会、日本信頼性学会関西支部、日本機械学会関西支部、
応用物理学会関西支部、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会、電気
学会関西支部、日本材料学会関西支部、電子情報通信学会関西支部、電気鍍金研究
会、表面技術協会関西支部、日本接着学会関西支部、化学工学会関西支部、大阪府立
大学 ものづくりイノベーション研究所（依頼中含む）
期 日：2019年11月7日（木）13：30～19：00（13：10受付開始）
会 場：大阪大学中之島センター 講義室702（大阪市北区中之島4-3-53）
<http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php>

プログラム：

13：30～13：35 開会挨拶
13：35～16：50 「材料力学から見た電子実装部の信頼性評価手法」
鹿児島大学工学部 教授 池田 徹 先生
16：50～16：55 閉会挨拶
17：00～19：00 技術交流会

定 員：60名（定員になり次第締め切ります）
参 加 費：JIEP 会員、協賛学協会会員 6,000円（クーポン利用可）、
非会員 12,000円、学生 3,000円

*税込、技術交流会費込。参加申込み受付後、振込先をお知らせします。

*非会員で申込みと同時にエレクトロニクス実装学会にご入会いただいた方は、会員扱いとさせていただきます。ご入会を希望される方は、その旨明記の上お申込み下さい。

会員特典 1. 参加費割引（今回の会費から会員価格が適用されます。）
2. 学会誌配布（年7回）
3. 10月からは、本年度の年会費が半額の5000円で入会できます。

【申込み方法】エレクトロニクス実装学会ホームページの若手研究会セミナーご案内
（<https://web.jiep.or.jp/kansai/event.html>）の参加申込みフォームからご登録下さい。

【問合先】エレクトロニクス実装学会 関西支部事務局（若手研究会セミナー担当）
young-kansai(*)jiep.or.jp ((*⇒@) Tel.06-6878-5628 Fax 06-6879-7568